

很多人认为本校复试不重要,其实初试成绩除以 5 再乘以 60%之后大家都相差不多,而复试真正能拉开很大的距离的,所以复试也不能掉以轻心,下面我稍稍介绍下复试的情况,希望对 2011 材控考研的学弟学妹们有所帮助。

复试分为两个部分,笔试和面试。

笔试开始有六道题。第四、五题是微机原理的,我也没看,其他的是材料成型原理和工艺

两本书上的,还有一道送分题。(六选三)题目如下:

1.材料有哪几类,各有什么特点,应用范围?

2.简述冲压工艺的原理,特点,及应用范围。

3.列举获得细等轴晶的常用方法。

4/5 是微机原理的

6.读研的原因,打算,以及与本科段的区别(送分题)

笔试还有一个翻译,大概在 100 字左右,我们考的好像是微型铸造与封装(不知道我看懂没),句子不难,就是有些专业词汇不认识。

下面就是面试了。

开始有个思想素质面试,就是学工组的几位老师和几个学生问你几个问题,一般就是自我介绍,家庭情况啊等的,基本上就是走过场。

后面还有三个面试,分别是[英语](#)组,专业组和基本技能组。

1.英语面我们还是比较幸运的,没有听力,就是有一个自我介绍,然后简单的几个问题。建议自我介绍不要太长,一般老师都会打断你的自我介绍,问问题,问题主要集中在导师的情况上,所以要对你你的导师及研究方向有所了解,还有一个好像是对导师的印象。本校的基本上就是这些,一般不会太难。

2.基本技能组就是开始一个简短的自我介绍,运气好的就是问问毕业设计的问题,运气不好可能就要画图了,像铁碳相图啊,应力应变相图啊,听说还有老师叫别人画两个圆距的相贯线,螺纹等。

3.专业知识组。就是有很多题目,从中抽取一道来回答。题目一般都是材料成型原理和工艺两本书上(当然考微机原理的还可以选择微机原理的题),一般老师开始会问你擅长于哪一方面,然后为给你相应方面的问题来抽。在前面的会吃点亏,题目只有那几道,后面回答的基本上所有的题目都已经知道了。(如果抽到的题不会,一般老师都会让你重抽)